

**特点:**

- 低插入损耗: 最大值 1.2dB
- 高带外抑制: 典型值 50dB
- 良好的带内驻波比: 典型值 1.5:1
- SMT 封装
- 封装尺寸: 15.5×10.5×4.5mm
- 产品执行标准为 SJ20527A-2003

**图片:**

**性能参数 (25°C):**

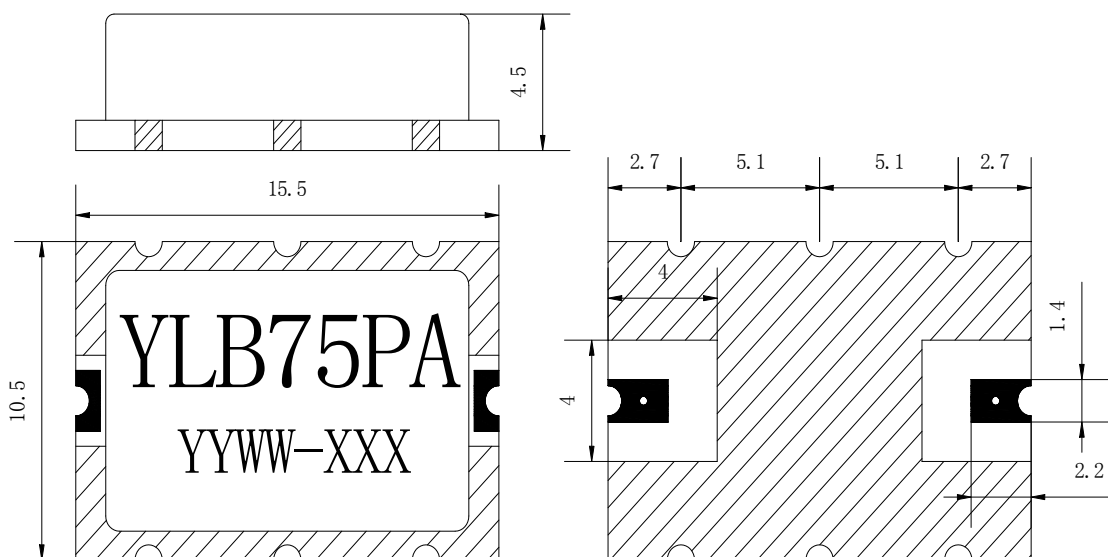
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
截止频率	$f_c$		65		75	MHz	全温
插入损耗	IL	$P_{IN}=0dBm$ $f_{TEST}=65\sim75MHz$			1.2	dB	全温
输入带内驻波比	VSWR <sub>i</sub>	$P_{IN}=0dBm$ $f_{TEST}=f_c\pm 2MHz$		1.5:1	2.0:1		全温
输出带内驻波比	VSWR <sub>o</sub>			1.5:1	2.0:1		全温
绝对群时延	$T_s$	$P_{IN}=0dBm$ $f_{TEST}=65\sim75MHz$			20		
阻带抑制	SR <sub>1</sub>	$P_{IN}=0dBm$ $f_{TEST}=140\sim2000MHz$	50			dB	全温
	SR <sub>2</sub>	$P_{IN}=0dBm$ $f_{TEST}=2001\sim4000MHz$	20			dB	全温
工作温度	T		-55		+85	°C	
质量	m				5.0	g	

**极限参数表:**

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
储存温度	-55~+100	°C	输入射频功率	30.0	dBm

**封装外形及引脚标识图:**

单位: mm 公差: ±0.2mm



**字符标志:**

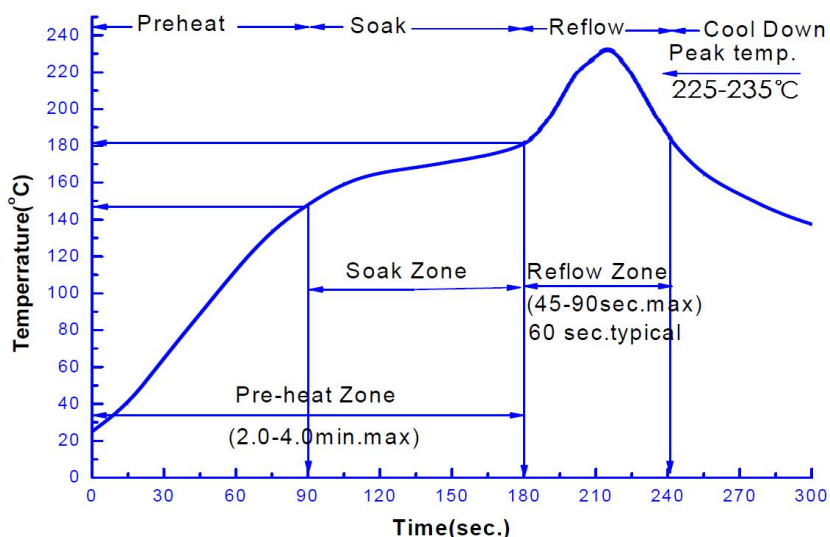
YLB75PA	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号

**引脚定义:**

接口标识	接口说明
■	RF IN, RF OUT (可互换)
///	GND

**产品使用注意事项:**

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域），为了保证连接良好，底部引脚焊好之后，需对侧面引脚进行补焊；
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃ 回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 235℃。

4. 如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间 3~5 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。